

公司代码：603501

转债代码：113616

公司简称：韦尔股份

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税），预计分配现金红利总额为 273,293,805.65 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.10%。公司 2020 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	韦尔股份	603501	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾渊	任冰
办公地址	上海市浦东新区上科路88号	上海市浦东新区上科路88号
电话	021-50805043	021-50805043
电子信箱	will_stock@corp.ovt.com	will_stock@corp.ovt.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所属行业

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业划分，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

（二）公司主要业务情况

公司自 2007 年设立以来，一直从事半导体产品设计业务和半导体产品分销业务。2019 年 8 月，公司完成了收购北京豪威及思比科的重大资产重组事项，2020 年 4 月，公司从 Synaptics Incorporated 收购了基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片（TDDI）业务。在前述收购完成后，公司主营业务仍旧为半导体产品设计业务和半导体产品的分销业务两部分，2020 年度公司半导体设计业务收入占主营业务收入的比例为 87.42%，较上年同期半导体设计业务收入增长 52.02%。

目前公司半导体产品设计业务主要为图像传感器产品、触控与显示驱动集成芯片和其他半导体器件产品。

公司图像传感器产品中最主要的产品为 CMOS 图像传感器芯片，2020 年度实现营业收入 1,469,692.38 万元，占公司 2020 年度半导体产品设计研发业务营业收入的比例达 85.11%。公司作为全球知名的提供先进数字成像解决方案的芯片设计公司，产品已经广泛的应用于消费电子和工业应用领域，包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、网络摄像头、安全监控设备、数码相机、汽车和医疗成像等。公司图像传感器产品丰富，包括 CMOS 图像传感器芯片、硅基液晶投影显示芯片（LCOS）、微型影像模组封装（Camera Cube Chip）、特定用途集成电路产品（ASIC），其中 CMOS 图像传感器芯片产品型号覆盖了 8 万像素至 6,400 万像素等各种规格，公司具备完善的产品体系。针对不同应用领域的各类应用设备，公司可根据不同设备的尺寸大小、光敏度、封装类型以及芯片内嵌式图像信号处理等方面的区别，提供特色化的产品解决方案。

触控与显示驱动集成芯片，主要应用于智能手机、平板电脑等领域。TDDI 核心团队继承原 Synaptics Incorporated 位于亚洲的 TDDI 产品研发和支持团队，凭借在触控与显示技术领域深厚的研发投入、广泛的知识产权积累，以及在全球领先手机客户的丰富量产经验，形成了在触控和显示领域丰富的产品组合，快速实现量产。2020 年度实现营业收入 74,376.72 万元，占公司 2020 年度半导体产品设计研发业务营业收入的比例达 4.31%。

公司其他半导体器件产品主要包括分立器件（包括 TVS、MOSFET、肖特基二极管等）、电源管理 IC（Charger、LDO、Switch、DC-DC、LED 背光驱动等）、射频器件及 IC、MEMS 麦克风传感器等产品线，已经与国内知名手机品牌供应链进行合作。在中美贸易摩擦不断的背景下，公司抓住国产替代加速的机会，在其他半导体器件产品领域客户发展上也有着明显突破。

同时，公司作为国内主要半导体产品分销商之一，凭借着成熟的技术支持团队和完善的供应链管理体系，同全球主要半导体供应商及国内各大模组厂商及终端客户继续保持着密切合作。

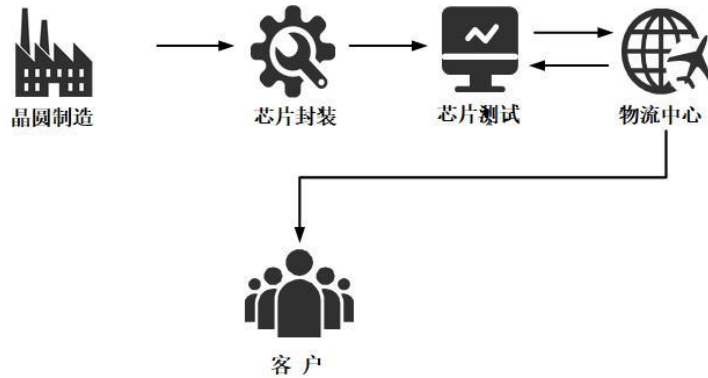
（三）公司经营模式

考虑到公司半导体设计业务及半导体分销业务并存的特性，根据行业及公司现状，公司在经营模式上有效整合了半导体设计和分销业务。公司设计业务依托公司分销业务的渠道优势，利用分销体系分析的客户需求信息，有针对性的提供满足客户需求的产品，并为公司产品研发方向提供市场信息作为参考。同时，公司分销业务凭借设计业务积累的技术优势，能为下游客户提供更好的解决方案，保证公司在分销业务市场的竞争优势。

1、半导体设计业务

(1) 公司采用 Fabless 的业务模式

公司半导体设计业务属于典型的 Fabless 模式，公司仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工厂商、封装测试厂商，公司从晶圆代工厂采购晶圆，委托集成电路封装测试企业进行封装测试。



公司生产芯片的原材料主要为晶圆。公司将设计的版图交由晶圆代工厂进行掩膜，以制作光罩。晶圆裸片由晶圆代工厂统一采购，公司采购由晶圆代工厂加工、测试后带有多层电路结构的晶圆。公司合作的晶圆代工厂主要为行业排名前列的大型上市公司，市场知名度高，与公司有着长期稳定的合作关系，产品供应稳定。

公司产品的封装测试环节委托封装测试厂商完成。报告期内，公司合作的封装测试厂商主要为封装测试的大型上市公司，经营稳定，市场知名度较高，能够按照产能和周期安排订单生产，报价基于市场化原则，公司与其交易价格公允。

公司产品覆盖的市场范围较广，根据行业、产品及市场需求情况，公司相应选择直销和代销的方式进行销售。总体而言，公司的销售模式以直销为主、代销为辅。公司采用直销模式的客户主要为模组厂商、ODM 厂商、OEM 厂商及终端客户，直销模式可以保障公司服务效率，根据终端客户的需求及反馈信息以最快的响应速度进行调整。除直销外，公司还通过知名跨国大型经销商进行代销。利用代销模式，公司可有效降低新客户开发的成本，在控制中小规模客户的应收账款回款风险的同时，也降低了公司对中小规模客户销售管理的人力资源及成本支出。

(2) 公司设计业务产品类型

目前公司半导体产品设计业务主要为图像传感器产品、触控与显示驱动集成芯片和其他半导体器件产品，具体产品包括以下部分：

产品名称	主要功能	应用领域	技术优势
------	------	------	------

产品名称	主要功能	应用领域	技术优势
CMOS 图像传感器	将接收到的光学信息转换成电信号,是数字摄像头的重要组成部分	消费类电子、安防、汽车、医疗、AR/VR 等	8 万像素到 6400 万像素领域全面覆盖;可实现摄像头更高速的自动对焦;降低功耗并保障了图像质量;显著提升在无光和低光环境下的图像捕捉能力;能捕捉高速移动物体,且不会产生空间失真;可根据不同设备的尺寸大小、光敏感度、封装类型以及芯片内嵌式图像信号处理等方面的区别,提供特色化的产品解决方案
微型影像模组封装 (Camera Cube Chip)	采用先进的芯片级封装技术整合集成晶圆级光学器件和 CMOS 图像传感器创新的解决方案,可以提供图像传感、处理和单芯片输出的全部功能	医疗、手机、物联网、AR/VR 眼球追踪等	目前医疗内窥镜领域技术最先进的摄像头之一;提供业界最小的相机模组解决方案;使用半导体工艺制造镜头;可过回流焊,无需底座或人工插接模组
硅基液晶投影显示 (LCOS)	反射模式,尺寸非常小的矩阵液晶显示装置	可穿戴电子设备、移动显示器、微型投影、汽车和医疗机械等	LCOS 将控制电路放置于显示装置的后面,可以提高透光率,从而达到更大的光输出和更高的分辨率。为微型投影系统提供了一个高解析度 (HD)、外形紧凑、低功耗和低成本的微型显示器解决方案
特定用途集成电路产品 (ASIC)	支持公司 CMOS 图像传感器,在摄像头和主机之间起到桥梁功能的作用,提供 USB、并行、串行接口解决方案以及压缩引擎和低功耗图像信号处理等功能	汽车等	支持高动态范围、多路环视影像处理,同时支持鱼眼矫正、画中画、图像叠加等高级图像功能的实现,提供完美的汽车影像解决方案;可进行多路摄像头的拓展,并且支持多幅图像的拼接处理
TDDI 触控和显示驱动集成芯片	接收手机主机输出的图像数据,驱动 LCD 屏显示,并且侦测用户触控信号进行与智能手机的人机交互	智能手机	产品全覆盖,从 HD 720P 到 FHD 1080P,显示帧率从 60Hz, 90Hz, 120Hz 到 144Hz 全覆盖,触控报点率支持 120Hz 到 240Hz。基于专利技术,提供图像色彩,对比度,清晰度等增强方案;提高触控信噪比,降低误触率和失效率;降低功耗,并通过减少外围元器件帮助客户降低综合成本。可根据不同的尺寸大小、分辨率、封装类型提供特色化的产品解决方案。
TVS	提高整个系统的防静电/抗浪涌电流能力	消费类电子、安防、网络通信、汽车等	采用先进的沟槽技术和超薄化封装技术,可提供最小封装尺寸达 0.6mm*0.3mm 规格封装的产品,并已进入国内第一批电容小于 0.4PF 产品的量产阶段,其 ESD 性能具备国际领先水平

产品名称	主要功能	应用领域	技术优势
MOSFET	信号放大、电子开关、功率控制等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	拥有多层外延技术、背面减薄技术和芯片倒装技术等多项核心技术，目前最小 pitch（特征尺寸）小于 1 μ m，最小设计线宽小于 0.2 μ m
肖特基二极管	电源整流，电流控向，截波等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	采用先进的沟槽技术，产品具有优异性能指标及电学参数
LDO	具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能	消费类电子、安防、网络通信、汽车等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富，并形成专利技术
DC-DC	起调压的作用（开关电源），同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用	消费类电子如笔记本电脑、电视机、机顶盒等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富，并形成专利技术
LED 背光驱动	构造一个恒流源电路，确保任何条件下背光 LED 的发光亮度不变	手机、平板电脑、笔记本电脑、电视机等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富，并形成专利技术
模拟开关	信号切换、功能切换等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富，并形成专利技术
射频芯片	信号放大、信号传输	移动通信	提供国内首创多模/多频功放新架构射频芯片，并开发了 TD-LTE 射频功放技术
MEMS 麦克风	实现声信号转换为电信号	消费类电子如智能音箱、无线耳机等	应用特有的封装结构提高声学性能，尺寸小，高信噪比，功耗低

2、半导体产品分销业务

（1）半导体产品分销业务模式

公司作为典型的技术型半导体授权分销商，与原厂有着紧密的联系。公司拥有经验丰富的 FAE 队伍，顺应国内半导体行业的产业地域布局，公司分销体系境内外多地设立了子公司，构建采购、销售网络、提供技术支持、售后及物流服务等完整的业务模块。

公司半导体产品分销业务采取买断式采购的模式，具体分为境内采购和境外采购两部分：①境内采购主要由北京京鸿志及其他子公司在境内进行；②境外采购主要由香港华清及其他子公司在境外进行。

基于对半导体元器件性能及下游电子产品的理解及分析，公司主动为客户提供各种产品应用咨询、方案设计支持、协助客户降低研发成本，以使其能够将自身资源集中于电子产品的生产和市场推广，同时也能更好的了解客户的需求，进而使得公司研发设计业务下开发的产品能够顺应

市场需求作出迅速的反应。技术型分销能够更好的满足客户对电子产品的理解及需求，代表着半导体元器件分销行业的主流趋势。

(2) 半导体分销业务产品类型

分销的产品可分为电子元件（包括电阻、电容、电感、晶体、接插器、连接器等）、结构器件、分立器件、集成电路、显示屏模组等。

产品名称	细分产品	主要代理原厂	应用领域
电子元件	电阻、电容、电感等	松下、乾坤、国巨、三星、AVX、LIZ、WALSIN、HEC等	移动通信、家用电器、安防电子、数码产品、智能穿戴、金融支付、工业设备、电力设备、电机控制、电源、仪器仪表、汽车及部件、消防、照明、轨道交通等
结构器件	连接器、卡座、卡托、PCB等	Molex、松下、南亚等	
分立器件	光电半导体器件、晶振、半导体等	光宝、TXC、VISHAY等	
集成电路	芯片、Sensor、Memory、Flash等	光宝、江波龙、XMC、Zetta、ISSI等	
射频器件	滤波器等	松下、ACX等	
显示屏模组	PMOLED、LCM、AIT等	智晶、LGD等	车载市场

公司会根据自身代理产品的具体情况并结合市场因素，对所代理的产品线进行动态管理。在开发新产品线的同时，对某些竞争力较弱、可替代性较高等不符合公司分销业务发展战略的产品公司进行过滤，将逐步降低代理数量或不再代理。由于终端设备市场产品更新换代速度较快，公司需同下游模组厂商和终端厂商保持紧密合作关系，在及时了解市场趋势和终端厂商在研产品需求的基础上，有针对性的进行技术研发和储备，使企业的新技术能顺应市场变化，减少下游行业变化带来的负面影响。

(四) 公司所处行业与上、下游行业之间的关系

半导体产业链大致可分为设备与原料供应商、制造商、芯片设计原厂、分销商、方案商及下游电子产品制造商等几个环节。从产业链来看，芯片设计和制造是半导体行业的核心技术环节。

1. 上游行业对公司的影响

(1) 半导体设计业务

公司半导体设计业务采用 Fabless 模式，仅从事产品的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工厂商、封装测试厂商进行产品生产。晶圆代工厂、封装企业和测试企业是公司半导体设计业务的上游行业，对公司的影响主要体现在以下几个方面：

第一、产品良率方面。随着集成电路技术的日新月异，高运算量相关应用持续带动半导体产业对先进制程的需求，而先进制程对晶圆代工厂的产品良率提出了极高的要求，若公司不能同晶圆代工、封装测试企业紧密合作，通过不断调整产品设计和制程工艺提高良率，将会对公司产品生产造成影响。

第二、产品成本方面。由于晶圆代工厂投资额较大，技术难度较高，且需要较长时间的经验积累才能使良率保持在较高水平，全球晶圆代工行业集中度较高，根据 IC Insights 统计的数据，截止 2020 年底，全球前五大晶圆厂的产能总和占到了全球晶圆产能的 54%。在这种情况下，晶

圆代工企业在产业链中的议价能力较强。同时，由于制造图像传感器有特定的技术要求，能满足公司相关产品生产要求的晶圆代工厂在市场上为数不多。在公司半导体设计业务成本中，晶圆成本占比约 71.95%，封装测试成本占比约 18.80%。晶圆代工厂及封装测试厂若因供需关系紧张调整价格将对公司产品成本产生直接影响。

第三、产能供应方面。根据“摩尔定律”，当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。因此集成电路产品的生命周期较短，产品更新换代速度较快。根据市场潮流和终端设备厂商需求及时推出新产品并保障产能供应，是公司维持市场竞争力的核心要素。在这种情况下，上游代工企业的整体产能以及产能利用率，将直接影响公司的交货周期和新产品量产能力。

(2) 半导体分销业务

公司半导体分销业务主要为授权代理分销。公司主要代理光宝、松下、Molex、国巨、南亚等知名的半导体生产厂商的产品，若上述原厂在公司代理权到期后取消与公司的合作关系，或改变代理政策，将对公司的经营业绩产生影响。

2. 下游行业对公司的影响

公司业务的下游行业为终端设备市场，下游行业需求量的增减变化将对公司业绩产生直接的影响，同时下游终端的需求量变化会对公司上游行业产能供应及定价政策有明显的影响。为了降低单一终端领域对公司业绩的影响，公司近年来不断丰富公司产品应用领域，减少下游需求变化带来的负面影响。

此外，由于终端设备市场产品更新换代速度较快，公司需同下游模组厂商、ODM/OEM 厂商、终端厂商等保持紧密合作关系，在及时了解市场趋势和终端厂商在研产品需求的基础上，有针对性的进行技术研发和储备，使企业的新技术能顺应市场变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减 (%)	2018年	
				调整后	调整前
总资产	22,647,992,328.94	17,476,223,432.68	29.59	15,589,356,096.62	4,599,872,273.92
营业收入	19,823,965,431.66	13,631,670,629.57	45.43	9,701,902,368.56	3,963,509,424.61
归属于上市公司股东的净利润	2,706,109,337.61	465,632,238.67	481.17	144,991,902.55	138,804,364.26

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,245,073,139.31	334,201,677.11	571.77	132,553,764.37	132,553,764.37
归属于上市公司股东的净资产	11,238,642,949.21	7,926,394,295.30	41.79	3,983,942,540.00	1,635,555,967.17
经营活动产生的现金流量净额	3,344,594,067.54	805,335,234.79	315.30	790,006,614.66	5,401,858.32
基本每股收益(元/股)	3.21	0.76	322.37	0.29	0.32
稀释每股收益(元/股)	3.19	0.73	336.99	0.30	0.33
加权平均净资产收益率(%)	29.06	10.17	增加18.89个百分点	4.94	10.08

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,816,543,985.76	4,226,334,738.50	5,925,990,066.64	5,855,096,640.76
归属于上市公司股东的净利润	445,109,124.07	544,986,809.48	736,477,441.32	979,535,962.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	436,000,225.06	491,745,455.54	658,462,952.83	658,864,505.88
经营活动产生的现金流量净额	-86,831,881.27	296,198,374.47	168,874,549.78	2,966,353,024.56

公司第四季度经营活动产生的现金流量净额差异较大主要是因为：公司第三季度营业收入增长较多，环比增长幅度较大，销售收到的现金在第四季度实现；以及公司 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解锁流通上市，公司代收的员工股权激励个税增加。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

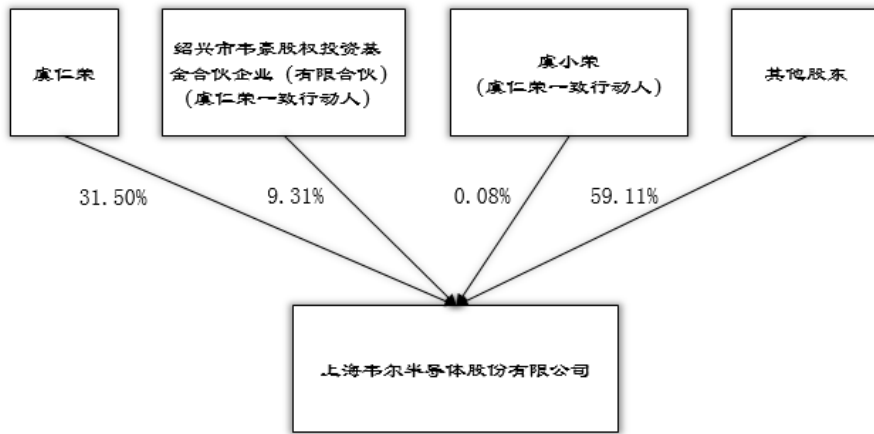
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						41,835	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						44,551	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
虞仁荣		279,435,000	32.21		质押	129,780,000	境内 自然人
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）		80,839,009	9.32	80,839,009	质押	40,000,000	境内非国 有法人
香港中央结算有限公司	22,717,166	44,981,069	5.18		无		境外法人
青岛融通民和投资中心（有限合伙）	-18,179,072	44,008,001	5.07		无		境内非国 有法人
嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）	-4,417,742	22,396,342	2.58		无		境内非国 有法人
嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）	-4,447,746	22,366,338	2.58		无		境内非国 有法人
Seagull Strategic Investments (A3), LLC	-8,928,709	22,051,510	2.54		无		境外法人
上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）	-8,894,719	14,102,313	1.63		无		境内非国 有法人
中国工商银行股份有限公司一诺安成长股票型证券投资基金	9,468,019	14,051,364	1.62		无		境内非国 有法人
Seagull Investments, LLC	-9,419,253	13,481,810	1.55		无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）为虞仁荣先生控制的企业，虞小荣先生系虞仁荣先生弟弟，均为虞仁荣先生一致行动人；嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、北京华清博广创业投资有限公司均为吕大龙先生控制的企业，嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、北京华清博广创业投资有限公司为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

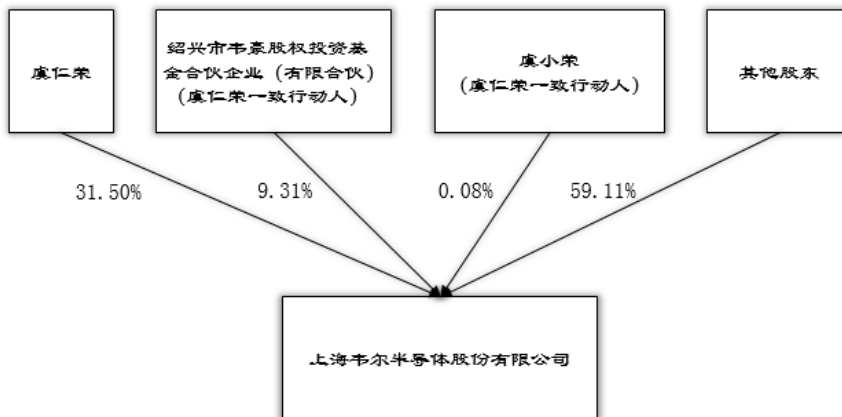
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
长三角科创企业 2020 年度第一期集	20 长三角科创集合 CP001	042000465	2020-10-29	2021-10-30	20,000	3.30	到期一次还本付息	中国银行间市场交易商协会

合短期 融资券								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司公布的跟踪评级报告，“20 长三角科创集合 CP001”债项信用等级为 A-1 级，等级释义为：最高级短期债券，其还本付息能力最强，安全性最高。公司主体信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，等级释义为：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	49.11	54.48	-5.37
EBITDA 全部债务比	0.3479	0.1584	119.63
利息保障倍数	9.04	2.47	265.75

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业总收入 198.24 亿元，较 2019 年增长 45.43%；公司归属于母公司股东的净利润为 27.06 亿元，比 2019 年增加 481.17%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明，请见公司 2020 年年度报告“第十一节 财务报告/四、财务报表编制基础/44、重要会计政策和会计估计的变更。”

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海韦矽微电子有限公司
韦尔半导体香港有限公司
Will Semiconductor (Japan) G.K.
豪威触控与显示技术有限公司
香港树伟朋电子科技有限公司
香港华清电子（集团）有限公司
香港天勤电子（集团）有限公司
香港鸿光兴盛电子有限公司
CREATIVE LEGEND INVESTMENTS LTD
新传半导体（香港）有限公司
新传（绍兴）半导体有限公司
武汉韦尔半导体有限公司
合肥韦豪半导体技术有限公司
北京泰合志恒科技有限公司
武汉泰合志恒科技有限公司
合肥泰合志恒科技有限公司
上海矽久微电子有限公司
无锡中普微电子有限公司
安浦利科技有限公司
上海韦玗微电子有限公司
无锡韦尔半导体有限公司
武汉耐普登科技有限公司
上海磐巨电子科技有限公司
上海韦孜美电子科技有限公司
上海夷易半导体有限公司
绍兴韦豪半导体科技有限公司
香港韦豪半导体有限公司
绍兴豪威半导体有限公司
北京韦豪集成电路设计有限责任公司

北京京鸿志科技有限公司
深圳市京鸿志电子有限公司
深圳市天勤汇智科技有限公司
苏州京鸿志电子有限公司
深圳市京鸿志物流有限公司
鸿光电子元件（深圳）有限公司
上海灵心电子科技有限公司
香港灵心电子科技有限公司
深圳东益电子有限公司
香港东意电子有限公司
上海树固电子科技有限公司
上海芯仑光电科技有限公司
CELEPIXEL TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE. LTD
HILLHOUSE TECHNOLOGY PTE. LTD
浙江韦尔股权投资有限公司
上海韦尔置业有限公司
武汉韦尔投资管理有限公司
杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳市芯能投资有限公司
深圳市芯力投资有限公司
北京视信源科技发展有限公司
北京思比科微电子技术股份有限公司
思比科（香港）有限公司
太仓思比科微电子技术有限公司
天津安泰微电子技术有限公司
北京豪威科技有限公司
Seagull Investment Holdings Limited
Seagull International Limited
OmniVision Technologies, Inc.
OmniVision International Holding Limited
OmniVision Technology International Ltd.
OmniVision Technologies (Hong Kong) Company Limited
OmniVision Trading (Hong Kong) Company Ltd.
OmniVision Technologies Development(Hong Kong) Company Limited
豪威半导体（上海）有限责任公司
豪威科技（上海）有限公司

台湾豪威科技有限公司
台湾豪威国际科技有限公司
OmniVision Holding (Hong Kong) Company Limited
OmniVision Investment Holding (BVI) Ltd.
北京豪威亦庄科技有限公司
上海全览半导体技术有限公司
OmniVision Optoelectronics Company Limited
豪威光电子科技（上海）有限公司
台湾豪威光电科技股份有限公司
OmniVision Semiconductor Technologies Marketing India Private Limited
OmniVision Technologies Norway AS
OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd.
豪威科技（武汉）有限公司
OmniVision Technologies Japan G.K.
OmniVision CDM Optics, Inc.
OmniVision International US LLC
OmniVision International Ontario LP

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司 2020 年年度报告“第十一节 财务报告/八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益”。